

证券代码：301095

证券简称：广立微

## 杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流
活动参与人员	广发基金、宝盈基金、光大证券、中信建投、浙商证券、南方基金、信达澳亚、中泰证券、国投瑞银、兴全基金、中欧基金、招商信诺、国泰君安、歌斐资产、联储证券自营、朔盈资产、嘉沃投资 17 家机构。
时间	2023 年 5 月 22 日-2023 年 5 月 25 日
地点	公司会议室
形式	现场会议
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李莉莉
交流内容及具体问答记录	<h3>一、公司概况</h3> <p>广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。</p>

## 二、问答环节

### 1、公司以成品率提升的制造类 EDA 为起点，是如何逐渐发展成为软硬件相互驱动的独特业务生态的企业？

公司的成品率提升方法以高效的电性检测为手段，因此公司的产品线围绕电性检测技术方法不断丰富扩展，解决了测试对象的设计、测试和数据分析三大环节的问题，形成了成品率提升的业务闭环。公司自 2003 年成立，2007 年聚焦于集成电路成品率提升制造类 EDA 软件，成功开发出一系列测试芯片设计软件，特别是公司的可寻址测试芯片，其创新的电路 IP 及测试结构间的摆放绕线技术，使同样面积内的测试结构数量提升十倍到几十倍，而测试结构数量的大幅度增加对测试设备的测试效率提出了更高的要求，因此，不解决测试效率问题将会导致 EDA 软件所设计出的设计方案优势无法有效发挥。基于上述原因，为了解决客户更多测试需求带来的测试效率问题，公司自 2010 年开始研发晶圆级快速电性测试机，配套公司的 EDA 软件设计方案，并将设备作为研发用机销售至海内外一流晶圆厂的研发部门使用。其后，公司经过了近十年的迭代研发和技术突破，电流测试精度达到了 pA 级以下的高精度标准，实现了研发用机到量产用机的升级转变，使产品应用广度从研发环节扩展应用到量产环节。回顾公司 WAT 测试设备的发展史，可以看出 WAT 测试设备和公司所在的成品率提升领域是紧密相关的，属于公司成品率提升技术和产品生态中的一部分，在公司的成品率提升业务闭环中处于测试和数据源收集的关键环节，也是公司第一个从先进工艺开发拓展到量产环节的产品。公司 WAT 设备快速进入晶圆厂的量产线，将会使公司软硬件产品间的协同效应凸显，进一步带动公司的各类 EDA 软件从工艺研发环节拓展到市场空间更广阔的量产环节，从而驱动 EDA 软件业务的增长。

未来，我们将构建贯穿集成电路全产业链的软硬件一体化产品生态，补齐制造类 EDA、完善智能化数据系统产品，同时不断增加电性测试设备品类，不断构筑更高的技术和市场竞争壁垒，助力公司业务稳健增长。

## **2、公司在数据软件端已经发布数款软件，目前该方向上的市场进展情况如何？**

在半导体制程不断向前的当下，数据密集带来的挑战日益凸显，提升良率除了从技术上调整之外，端到端全产业链的数据分析显得尤为关键。公司自 2020 年开始开发半导体数据软件系列软件，目前相关工具已经初具规模，并在国内多家大型集成电路设计、制造企业试用取得良好的反馈。2023 年 4 月 28 日，公司在上海举行 Semitronix DATAEXP User Forum，聚焦半导体大数据分析难点，分享 DATAEXP 大数据分析平台的新发展，发布了全线升级的良率分析管理、缺陷分析管理、通用数据分析管理等多款软件，获得了参与技术论坛的客户认可。随着计算机技术的进步，公司正在将人工智能、机器学习等先进技术融入到数据分析平台中，旨在帮助集成电路设计、制造及封测厂商发掘数据价值，实现高效、精确的海量数据关联分析，快速准确地识别定位良率问题，从而帮助用户及时采取措施，提前应对潜在风险，加速良率提升并保障产品良率的稳定性。同时，大数据分析平台产品对于公司软、硬件相结合的系统性解决方案的完善起到举足轻重的作用，能够进一步提升公司的产品与市场竞争格局，为公司的业绩提供新的增长引擎。

## **3、公司以往的研发投入占比较高，2023 年是否还会保持较高的研发投入？**

在研发投入方面，近三年来，公司持续加大研发投入，研发费用率一直保持在 30%以上，2022 年度，公司的研发费用额达到 12,353.91 万元，同比增长 88.65%。长期高比例

	<p>的研发投入是公司持续创新的动力源泉，也是公司业务的快速拓展的基础，2023 年公司将继续保持高研发投入以支撑公司新技术、新产品的开发，同时充分利用好募集资金，加快成品率技术相关软件的升级开发，进一步横向拓展研发其他 EDA 产品和晶圆级电性测试设备，发挥公司产品的软硬协同的优势，持续提高企业核心竞争力和技术水平。</p> <p><b>4、公司近期人员是否有进一步的扩充，未来的人员规划如何。</b></p> <p>2022 年度公司总人数 318 人，其中研发团队达到 248 人，较上年度增幅近 80%；2023 年基于公司新产品、新技术的拓展计划以及业务市场的不断扩大，公司人员增幅仍保持较快的增速；未来，随着公司在 EDA 软件、测试设备硬件等方面产品和技术的进一步横向拓展研发，公司客户群体及销售订单的不断增长，公司的人员团队将进一步扩大规模，预计 2023 年人员增长将保持在 50%以上。</p> <p><b>5、公司在晶圆级电性测试产品线上的研发进展如何？</b></p> <p>在晶圆级电性测试设备方面，公司的 WAT 测试机已经投入市场实现成熟应用并实现了高速增长营收效益，特别是公司的高效并行 WAT 测试机型，已经广泛应用于国内多家 12 寸晶圆厂及部分设计公司；为满足 6 寸、8 寸以及部分 12 寸晶圆厂对设备性价比的需求，2022 年度我们开始进行通用型机台 T4000 机型的优化升级，预计将于今年下半年正式推向市场。同时，面向晶圆级可靠性测试领域，公司扩展研发了晶圆级可靠性测试（WLR）设备，现已实现关键功能开发，扩充了公司电性测试设备产品线。2023 年 T4000 机型及可靠性测试设备均将投入市场 Demo 验证应用和推广，助力业务持续增长。</p>
关于本次活动是否涉	无。

---

及应披露重大信息的说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2023年5月26日